

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	申万宏源、中信证券、中金公司、中信建投、摩根士丹利、JP Morgan、UBS、兴证全球、天弘基金、东方红、平安基金、华夏基金、博时基金、申万菱信、华宝基金、中信保诚、安信基金、万家基金等100多家机构
时间	2025年10月27日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵奇 财务负责人：王伟 董事会秘书：张毅 芯联动力董事长：袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	芯联集成自2018年成立以来，始终聚焦“车规级芯片国产化”。9月公司顺利完成对子公司芯联越州的股权整合，注册资本提升至83.83亿元，公司资本实力与产业协同能力再上新台阶。 通过持续的产能扩张与技术迭代，公司构建了覆盖功率半导体与信号链芯片的代工制造能力，并向模拟和控制类持续推进，最终构建完整的一站式系统代工能力。2025年前三季度，公司实现营业收入54.22亿元，较上年同期增长19.23%，增长主要源于公司汽车、AI、工控、消费四大领域市场需求持续增长，尤其是AI领域增长显著，公司在新能源和智能化领域的市场竞争力不断得到巩固。在此基础上，公司将保持收入规模的扩大，经营状况的提升，预计全年将实现营业收入80亿元到83亿元，与上年相比增长23%到28%。前三季度毛利率3.97%，较上年同期增加4.4个百分点；归属于上市公司股东

	的净利润同比减亏32.32%，减亏2.21亿元，预计全年归母净利润同比将持续减亏。在资本开支上，公司从“规模扩张”向“技术深耕”转变。公司也将通过三大核心举措：（1）折旧占营业收入的比重逐步下降；（2）产能效率提升及持续推动降本增效；（3）碳化硅、模拟IC等高附加值业务占比逐步提升，持续改善公司盈利能力，为2026年实现全年盈利奠定基础。 公司将继续坚持以应用为牵引，依托技术+市场双轮驱动，积极把握新能源、智能化带来的战略性机遇，促进新能源汽车、AI、工控、消费四大领域引领成长，推动第四季度收入再创历史新高。 1、公司在AI方向的最新情况如何，有什么实质性的进展吗？请公司展开介绍一下具体情况。 在AI算力需求爆发的关键窗口，公司布局AI服务器电源的系统代工方案，产品可覆盖50%以上AI服务器电源价值。目前，芯联集成可以提供从一级电源、二级电源，到三级电源的一站式芯片系统代工解决方案，涵盖功率器件、驱动IC、磁器件、MCU、电流传感器等，并全力开拓800V高压直流（HVDC）市场，以进一步提升数据中心端到端供电系统效率。 第三季度，公司已完成8英寸SiC MOS器件送样欧美AI公司客户，标志着芯联集成在AI服务器电源等新赛道的突破取得实质进展。芯联集成将依托此前服务欧洲车企积累的客户服务经验，利用公司在欧美市场的渠道优势，加速AI服务器电源产品商业化的落地。 2、请问公司对AI服务器应用市场的展望及相关业务对公司未来收入增长的驱动力如何？ 公司从两年前开始布局AI服务器应用相关的产品和技术，从器件送样作为业务拓展的起点，到目前已经可以为供应商提供一级、二级、三级电源相关产品的系统化解决方案，从而实现客户能源转换效率的提升，并减少客户多个供应商的维护成本。 根据相关研究报告显示，未来AI服务器相关的市场规模在5000亿元左右，其中服务器电源占500亿元。目前客户对芯片集成的产品及系统解决方案充满期待，相关产品及技术通过验证后，AI服务器电源芯片及系统相关的业务将对公司产生持续的驱动力。 3、按照公司全年收入预测80-83亿元，预计Q4收入26-29亿元，请问公司对于四季度整体市场需求以及公司细分业务增长的驱动力主要来自哪些方面？
--	--

	第四季度，市场需求将延续稳定增长态势，公司各产线稼动率维持高位。目前可以看到，公司的汽车功率模块、激光雷达和消费类MEMS传感器等产品需求旺盛，供不应求。 从具体业务来看，（1）功率模块业务已连续多季度实现翻倍式增长。第四季度将继续保持高增长；（2）碳化硅产品规模化上量顺利，尤其是模块业务增长迅速；（3）全面发力储能、风光电、高压电网业务，新项目继续上量；（4）模拟IC代工方面，公司持续丰富产品料号，车规高压工艺平台和数模混合嵌入式控制芯片制造平台等量产规模持续释放。 同时公司积极把握智能化需求的机遇，目前公司MEMS传感器、激光雷达等芯片已占据国内主要市场份额；车载VCSEL芯片在前三季度已占据国内市场份额40%以上；高性能麦克风在某国际TOP手机终端上的使用份额超50%。 以上各项业务将共同推动第四季度收入再创历史新高，预计全年收入将达到80-83亿元，同时归母净利润将实现持续减亏。 4、安世半导体最近市场关注度较高，公司如何看待相关的市场环境的变化？ 公司一直密切跟踪市场需求的变化。短期内，安世事件引起的部分功率半导体需求外溢已形成明确订单机会；中长期看，国产替代进程有望再次全面加速，能为公司带来结构性成长机遇。 公司已在车规、工控及消费电子等领域，覆盖了国内多数主流设计与终端客户，并建立了快速的产品迭代能力与系统级的代工服务优势。在IGBT、MOSFET等关键器件上，已具备规模化承接转移订单的能力。 安世半导体在车载MOSFET和小信号功率器件有重要的地位，受到相关变化的影响，多个终端车厂和系统公司都积极与公司进行联络和沟通，匹配产品的替代情况。同时公司将进一步把握国产化窗口期的增长机遇，促进公司产品与市场持续的结构成长。 5、请公司介绍下GaN产品相关领域的布局以及采用的商业模式 公司一直关注GaN产品及技术的发展，也已布局相关产品。针对AI服务器电源的需求，目前公司一方面做一些GaN的器件级代工，同时也在不断推进为AI服务器客户提供功率(Si+SiC+GaN)+模拟芯片全系列高效电源系统化解决方案服务。
附件清单（如有）	无
日期	2025年10月27日